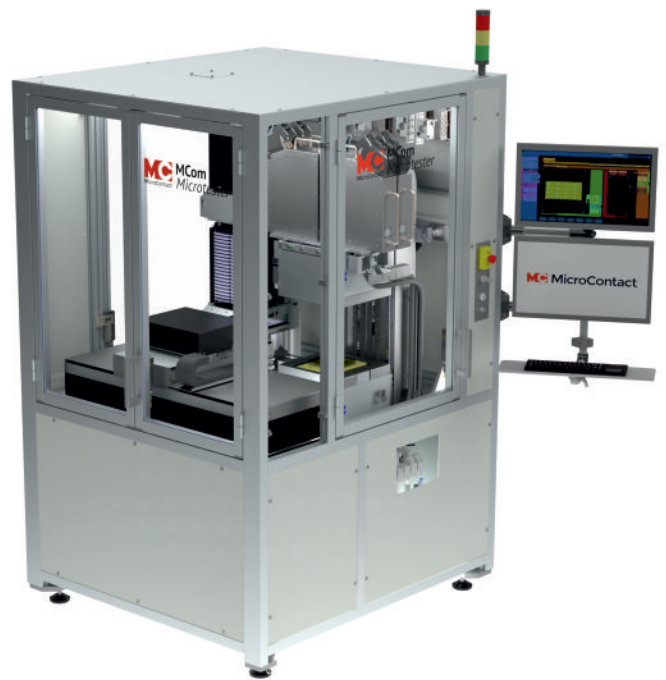


MCom

VOLLAUTOMATISCHES TESTSYSTEM FÜR E-TEST, FUNKTIONSTEST, IN-CIRCUIT-TEST ODER HOCHSTROMTEST



Der Microtester **MCom** ist ein vollautomatisches Testsystem zum beidseitigen Prüfen von bestückten und unbestückten Substraten. Die Zuführung der Substrate erfolgt kundenspezifisch ab Stapel, Magazin, Blister oder inline ab Förderband. Das visuelle Erkennungssystem PRS identifiziert und vermisst das Substrat beidseitig, bevor es lage- und versatzkorrigiert im Fine-Pitch Adapter positioniert wird. Zusammen mit der Sirius-Adapter-Technology ermöglicht der MCom Microtester das Kontaktieren von $\geq 40\mu\text{m}$ Testpunkten. Mehrfachnutzen werden in X- und Y- Richtung automatisch durchgesteppt. Für ein sicheres und schnelles Umrüsten sorgt ein Schnellspannsystem mit identifizierbaren Wechselsätzen. Zusätzlich können kundenspezifische Optionen wie Heiz- und Kühlstationen, Reinigungsprozesse oder eine visuelle Entwertung von fehlerhaften Substraten integriert werden.

Der MCom Adapter kann zum Debuggen des Prüfprogramms oder für Kleinserien auch im Handtestgerät MCit-8 eingesetzt werden.

Spezifikationen

Maschinentyp	Vollautomatisches Testsystem
Zuführung Substrat	Inline, Tray, Magazine, Stapel
Messtechnik	Open/Short/R, Flash, In-Circuit, Funktion, Hochstrom, HF
Adaptertyp	Adapter mit Starnadeln, Federkontakten, Hochstromkontakten oder HF-Kontakten
Kontaktierweise	Ein- oder doppelseitig
Kontaktierfläche	125 x 125mm (5" x 5")
Kontaktierkraft	≤ 1000N (optional auch höher möglich)
Testpunktgrösse	≥ 40µm
Testpunktabstand / Pitch	≥ 80µm
Substrat- / Trägergrösse (BxL)	≤ 250 x 300mm
Markiersystem optional	Inkjet, Laser, Markierstift
Substratreinigung optional	Reinigungsrolle oder Airknife
Wechseleinheit	Adapter und Raster mit Schnellspannsystem
Substratfixierung	Vakuum, Klemmung, Führungsstifte
Sonderhandling optional	Rotationseinheit 0° - 180°
PRS / Kamera	GigE Vision Kamerasystem
Substratidentifikation	OCR, 2D / 3D Code
Steuerung	Brick.Technology mit Windows 11
Bedienung	Touch Monitor mit Brick.Touch HMI
Kommunikation	SMEMA, OPC UA, MQTT, SQL, weitere Ethernet-Protokolle flexibel integrierbar
Dimension (BxTxH)	min. 1200 x 1200 x 1600mm
Gewicht	≥ 900kg
Versorgung	3 x 400V, 50/60Hz, 3kW, 6 bar Druckluft

Kontaktiermöglichkeiten

Nadelaustritt und daraus resultierende Minimalanforderungen

	Nadelaustritt	Ø Starnadel	Testpunkt	Pitch
PCB	0mm - 0.1mm	0.045mm	0.04mm	0.08mm
PCBA	0mm - 2mm	0.18mm	0.10mm	0.25mm
	2mm - 4mm	0.30mm	0.12mm	0.40mm
	4mm - 6mm	0.30mm	0.15mm	0.40mm